

インフィニオン テクノロジーズ 新製品のご案内

2025年10月



1	TO-247PLUS-4 リフローパッケージ搭載 CoolSiC™ MOSFET G2 1400 V
2	.XT技術およびSiC MOSFET 1200 V Gen 2を使用したEasy Cシリーズ
3	MOTIX™ TLE995x 32ビット モーター制御 SoC
4	DSO-12パッケージのCoolSET™固定周波数G5 Plus
5	CoolSiC™ MOSFET 400 V および 440 V Generation 2
6	CoolSiC™ MOSFET 650 V Gen 2, 75 mΩ 追加
7	沿面距離を確保したTO-247 4ピンパッケージに搭載されたCoolSiC™ MOSFET G2 1400 V
8	LITIX™ Interior シリーズ初の製品: TLD4020-3ET
9	OptiMOS™ 7 40 V S3O8 Automotive MOSFET
10	2.2 kV 整流器を搭載したEconoPIM™ 3 FP75R17N3E4_B20
11	HybridPACK™ Drive G2
12	OptiMOS™ 6 200 V MOSFET
13	PQFN 8x6パッケージ搭載OptiMOS™ 60 V パワーMOSFET
14	StrongIRFET™ 2 パワー MOSFET 30 V、D²PAKパッケージ
15	XENSIV™ - TLE49SRS8D / TLE49SRC8D デュアル角度センサー
16	評価ボード EVAL_TDA38725A_xxVOUT
17	評価ボード EVAL_TDA38740A_xxVOUT
18	評価デモボード: IPOLシングル出力同期電圧レギュレータ TDA38640A 用 1.0 Vout
19	安全放電機能付きコンデンサー基板 EVAL-DCLINK-DPT
20	1ED3330MC12M用評価デモボード
21	XENSIV™ PAS CO2 5 V CSK (Connected Sensor Kit)

TO-247PLUS-4 リフロー・パッケージ搭載 CoolSiC™ MOSFET G2 1400 V

TO-247PLUS-4 リフロー・パッケージに搭載された CoolSiC™ MOSFET ディスクリート

1400 V は、EV充電、ESS、CAVなどの大出力アプリケーションに適しています。

CoolSiC™ MOSFET G2 1400 V 技術は、優れた熱性能、電力密度の向上、高い信頼性を実現する最先端技術です。パッケージは、リフローに対応しており（最大3回のリフローハンダ付けが可能）、熱抵抗を低減し、高いピーク電流に対応します。



主な特長

- > きわめて低いスイッチング損失
- > パッケージの裏面は260°Cのリフローはんだ付けに最適（最大3回まで）
- > $T_{vj} = 200^\circ\text{C}$ まで過負荷での動作が可能
- > 短絡耐量時間 2 μs
- > IGBT並みの閾値電圧、 $V_{GS(\text{th})}=4.2\text{V}$
- > 寄生ターンオンに対する堅牢性、0 Vターンオフゲート電圧を印加可能
- > 転流向け本格使用に備えた堅牢なボディダイオード
- > .XT相互接合技術によりクラス最高の放熱性能
- > 幅広のパワー端子（2 mm）による大電流対応
- > バスバーに直接接続が可能な抵抗溶接対応ピン
- > 沿面距離（10.8 mm）を確保したTO247PLUS/パッケージ、CTI $\geq 600\text{ V}$

主な利点

- > 電力密度の向上
- > システム出力の向上
- > 全体的な効率の向上
- > 過渡的な過負荷、アバランシェ、ミラー効果に対する高い耐量
- > 過電流に対応したシステム設計が容易
- > 並列化が容易

競合製品に対する優位性

- > 1000 V超の設計が可能
- > リフローはんだ実装：熱抵抗を低減
- > 上限1000 Vのアプリケーション向けに、高いピーク電流での高速スイッチングに対応した十分な電圧マージン
- > 電力密度が高いため全体的なシステムサイズを削減

対象アプリケーション

- > 商用車、建設車両、農業車両（CAV）
- > EV充電
- > 蓄電システム（ESS）
- > オンラインUPS/産業用UPS
- > ストリングインバーター
- > 汎用ドライブ（GPD）

製品関連情報/オンラインサポート

製品ページ：

- > [IMYR140R008M2HXLSA1](#)
- > [IMYR140R019M2HXLSA1](#)

製品概要およびデータシートへのリンク

発注可能な部品番号	SP 番号	パッケージ
IMYR140R008M2HXLSA1	SP005931434	PG-T0247-4
IMYR140R019M2HXLSA1	SP005962804	PG-T0247-4

【TO-247PLUS-4 リフロー パッケージ搭載CoolSiC™ MOSFET G2 1400 V】

FAQ

1 What's are the advantages the TO-247PLUS-4 Reflow package?

The TO-247PLUS-4 Reflow package is specifically designed for high-output power applications. It's a robust package, which is reflow capable. It can be soldered three time at 260 Celsius. The reflow capability enables lower thermal resistance and results in up to 35 percent output power increase when combined with liquid cooling and active metal brazing (or A-M-B).

The wider pins provide higher lead current capability, delivering 18 percent more current than standard packages. The product is the perfect fit for harsh environment due to CTI> 600 V and a creepage distance of 10.8 mm.

2 What is the availability of the CoolSiC™ MOSFET 1400 V G2?

Standard material is available at distribution center. In addition, samples are available through our supply chain channels.

3 Any plan for CoolSiC™ 1400 V G2 package variants?

Yes, additional package variant of 1400 V will be available within 2025. The TO-247-4 HC package will be launched in Q4 2025.

.XT技術およびSiC MOSFET 1200 V Gen 2を使用したEasy Cシリーズ

EasyPACK™ 2C 1200 V 8 mΩ 3レベルモジュール、EasyPACK™ 2C 1200 V 8 mΩ 4パックモジュール、EasyPACK™ 1C 1200 V 13 mΩ 4パックモジュール:
CoolSiC™ MOSFET M2世代、NTC温度センサーを搭載し、大電流PressFIT接点技術を採用し、熱伝導材料 (TIM) 2.0塗布済み



主な特長

- > 優れたパッケージ コンセプト
- > システム寿命を延ばす、革新的な相互接続技術 (.XT)
- > 最新のCoolSiC™ M2チップ技術
- > 大電流PressFit ピン
- > NTC温度センサー内蔵
- > 最大 $T_{vj\ over}$ = 200°C の過負荷耐性
- > ゲート駆動電圧領域の拡大
- > 新しい熱伝導材料 (TIM) 2.0

主な利点

- > 優れたモジュール効率
- > システム効率の向上
- > 長い製品寿命
- > 高耐熱性
- > 導通損失の低減
- > コンパクトな設計
- > EasyPACK™ Bと完全互換

競合製品に対する優位性

- > 新しいEasy Cシリーズ モジュールは、Easy製品の次世代ラインナップで、高効率、高電力密度、容易な実装を求めるお客様に最適な製品。
- > CoolSiC™ MOSFET M2は改良されたモジュール アセンブリと.XT (長寿命) 相互接続技術を採用しています。標準的な相互接続技術よりもはるかに優れたパワーサイクル耐量を実現し、長期にわたり最高レベルの性能を提供します。

対象アプリケーション

- > DC-DCコンバータ
- > EV充電

製品関連情報/オンライン サポート

[製品ファミリーページ](#)

製品概要およびデータシートへのリンク

発注可能な部品番号	SP 番号	パッケージ
F413MXTR12C1M2H11BPSA1	SP006022175	AG-EASY1C-3211
F413MXTR12C1M2QH11BPSA1	SP006096036	AG-EASY1C-3211
F3L8MXTR12C2M2H11BPSA1	SP006020081	AG-EASY2C-3211
F3L8MXTR12C2M2QH11BPSA1	SP006082728	AG-EASY2C-3211
F48MXTR12C2M2H11BPSA1	SP006020085	AG-EASY2C-3211
F48MXTR12C2M2QH11BPSA1	SP006088082	AG-EASY2C-3211

【.XT技術およびSiC MOSFET 1200 V Gen 2を使用したEasy Cシリーズ】

FAQ

1 When are these parts available?

A: Parts are available and orderable according to standard lead time

MOTIX™ TLE995x 32ビット モーター制御 SoC

MOTIX™ MCU TLE995xは、最大700Wのコンパクト安価で、効率に優れたBLDCモーター制御アプリケーション向けのシングルチップ3相モータードライバーです。製品にはArm® Cortex®-M23が搭載されており、磁界方向制御 (FOC) に対応しています。内蔵されたCCU7は柔軟にPWM波形を生成でき、LINUARTを使った自動LINメッセージ処理により、CPUの負荷を大きく低減できます。さらに、TLE995xシステムオンチップ (SoC) はISO 26262に準拠 (ASIL B) し、Arm® TrustZone®を搭載しています。



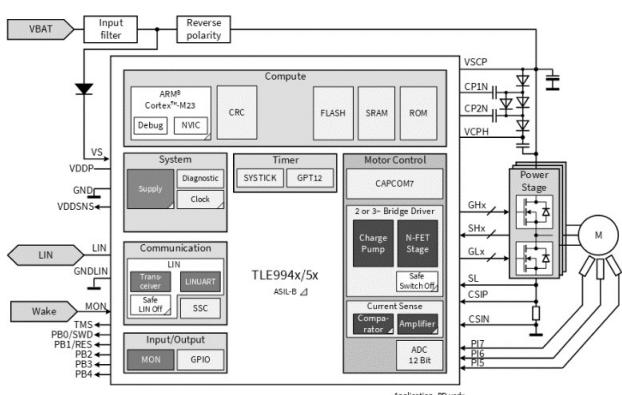
主な特長

- > 32-bit Arm® Cortex®-M23コア、40 MHz
- > フラッシュメモリ 72 kB、RAM 6 kB
- > LINトランシーバー、外部電源用電圧スイッチ、12ビットADCを内蔵
- > 5.5 V~29 Vの単一電源
- > 測定値が安定するまでの時間が短く、高精度な電流センスアンプ1個搭載
- > AEC-Q100 (Grade 0) 対応の車載品質
- > ISO 26262準拠 (ASIL B)
- > Arm® TrustZone®

競合製品に対する優位性

- > MOTIX™ TLE995xはコンパクトなSoCで、磁界方向制御(FOC)対応し、きわめて価格競争力の高いレベルでシームレスなデザインが可能です。

ブロック図



製品概要およびデータシートへのリンク

主な利点

- > コンパクトな設計による小型基板サイズ
- > 集積化によりシステムコストを削減
- > ASIL-B準拠の安全モーター動作
- > ペリフェラルの改善によりモーター制御を最適化
- > モーター制御評価用ソフトウェアおよびツール
- > エンドツーエンドのモーター制御ソリューションのプロバイダーMOTEON
- > IHRの認証LINドライバーおよびサポート

対象アプリケーション

- > 給水ポンプ
- > 冷却ファン
- > HVACブローウェー
- > オイルポンプ
- > シートアプリケーション

製品関連情報/オンラインサポート

製品ファミリーページ

発注可能な部品番号	SP 番号	パッケージ
TLE9954EQA40XUMA1	SP006012641	PG-TSDSO-32
TLE9954EQW40XUMA1	SP006012645	PG-TSDSO-32
TLE995XEVALBOARDTOBO1	SP006114152	L-MADK-1
TLE995XEVALKITTOBO1	SP006143050	L-MADK-1

【MOTIX™ TLE995x 32ビット モーター制御 SoC】

FAQ
1 Do you offer SW support? → Yes. 1) Free demos for evaluation purposes for 6 months (Configurable 6/12-step block commutation and FOC) 2) Licensed version can be ordered via our partner MOTEON. 3) PDL is deployed as part of free MOTIX™ MCU SDK including code examples and tool configs (Licenses by MOTEON)
2 What is the difference between TLE987x and TLE995x? TLE995x can be considered as performance and cost-optimized version of TLE987x. TLE995x has less GPIOs, (~ 70%) less computational performance compared to TLE987x, but offers enhanced peripherals at a competitive price , and safety and Arm TrustZone .
3 I could not download the data sheet from the website. Where Technical material can be found on myICP under a valid NDA

DSO-12パッケージのCoolSET™ 固定周波数G5 Plus

ICE5xRxxxxAG-1は、CoolSET™ 固定周波数の第5世代PLUSを搭載した、オフラインスイッチング電源向けに最適化されたカスケード構成のパワーICです。CoolSET™のパッケージは、独立した2つのチップを搭載しており、1つはコントローラーチップ、もう1つは700V/800V/950V CoolMOS™チップです。カスケード構成により高速起動を実現します。ソフトゲート駆動と周波数ジッタリング機能による周波数低減は、EMI (電磁干渉) を低減し、効率を向上させます。待機電力モード開始／停止レベルが選択可能なスタンバイ電源ABMは、スタンバイモードにおいて、超低消費電力と小さな出力電圧リップルを備えた出力待機電力モードを実現します。



主な特長

- > 高いアバランシェ耐量の700 V、800 V、950 V CoolMOS™
- > 最低待機電力 100 mW 未満を実現するアクティブバースト モードは、開始／停止を3レベルから選択可能
- > 周波数低減動作によりシステムの全体効率を向上
- > 周波数ジッタ、ソフトゲート駆動によりEMI を低減
- > 非絶縁型フライバックトポロジーでエラーアンプを搭載した直接的なフィードバック
- > 優れたピン電圧定格によりシステム設計が容易
- > 選択可能な加熱保護閾値
- > 前世代品G5とピン互換

主な利点

- > 絶縁型/非絶縁型の両トポロジーに対応
- > DSO-12パッケージに700 V、800 V、950 V CoolMOS™ スーパージャンクション最新世代を搭載
- > 最大出力42 W (AC85~300 V時)
- > 最高スイッチング周波数65 kHz, 100 kHz, 125 kHz
- > デバイス高い堅牢性

競合製品に対する優位性

- > 包括的な保護機能、システムの入出力に対応
- > 高いV_{cc}最大定格電圧 (35 V) とVERR/FB最大定格電圧 (5.5 V): 高い堅牢性により高い絶対最大定格を実現
- > 高いアバランシェ耐量のCoolMOS™ P7を搭載
- > 保護機能を高集積化
- > 内蔵エラーアンプによりPSRまたは非絶縁アプリケーション向けに追加される部品点数を削減

対象アプリケーション

- > コンシューマー向け機器
- > 補助電源
- > 洗濯機
- > エアコン
- > 冷蔵庫
- > サーバー
- > ホーム/ビルオートメーション
- > 産業用機器

製品関連情報/オンライン サポート

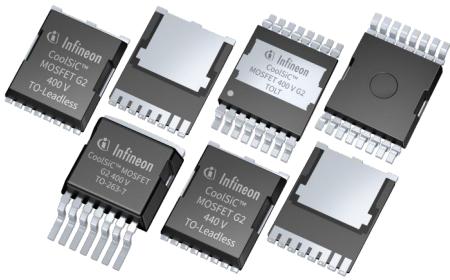
[製品ファミリーページ](#)

製品概要およびデータシートへのリンク

発注可能な部品番号	SP 番号	パッケージ
ICE5AR4770AG1XUMA1	SP005959829	PG-DSO-12
ICE5GR4780AG1XUMA1	SP005960065	PG-DSO-12
ICE5GR2280AG1XUMA1	SP005960073	PG-DSO-12
ICE5GR1680AG1XUMA1	SP005960076	PG-DSO-12
ICE5BR4780AG1XUMA1	SP006136473	PG-DSO-12
ICE5BR3995AG1XUMA1	SP006136475	PG-DSO-12

CoolSiC™ MOSFET 400 V および 440 V Generation 2

CoolSiC™ MOSFET 400 V および 440 V Gen 2は、高い堅牢性、超低スイッチング損失、オン抵抗を兼ね備え、システムコストの改善を実現します。2レベルおよび3レベルのハードスイッチングおよびソフトスイッチングトポロジーにおいて、きわめて高い電力密度とシステム効率を実現し、AIサーバーの電源装置、SMPS、モーター制御、再生可能エネルギー、エネルギー貯蔵、クラスDアンプにおける電力変換をターゲットとしています。



主な特長

- > 650 V SiC MOSFETよりも優れた性能指数 (FOM)
- > 低Q_{rr}の高速整流ダイオード
- > 低いR_{DSON}の温度依存性
- > ゲート閾値電圧 V_{GS(th)} = 4.5 V
- > ユニポーラ駆動 (V_{Gsoft}=0)
- > 100%アバランシェ耐量出荷テスト対応
- > スイッチング速度の高い制御性
- > 高dV / dt動作中の低オーバーシュート
- > .XT相互接続テクノロジー

主な利点

- > 高いシステム効率
- > 高電力密度設計
- > 高い設計上の堅牢性
- > EMIフィルタリングの必要性を低減
- > ハードスイッチングトポロジーでの使用

競合製品に対する優位性

- > 3L PFC、ANPCなどの最新トポロジーの利用が可能

製品関連情報/オンラインサポート

製品ファミリーページ

対象アプリケーション

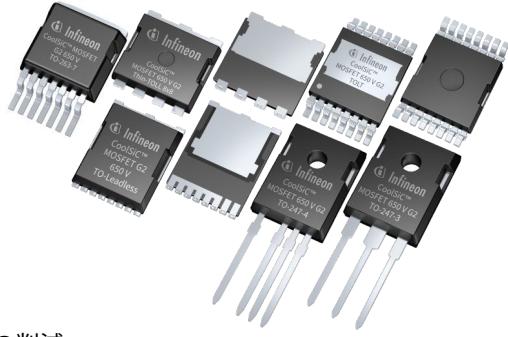
- > AIサーバー-PSU
- > SMPS
- > モーター制御
- > 小型電気自動車 (LEV)
- > フォークリフト
- > 航空

製品概要およびデータシートへのリンク

発注可能な部品番号	SP 番号	パッケージ
IMW40R011M2HXKSA1	SP006021005	PG-T0247-3
IMZA40R011M2HXKSA1	SP006021008	PG-T0247-4
IMW40R015M2HXKSA1	SP006021011	PG-T0247-3
IMZA40R015M2HXKSA1	SP006021014	PG-T0247-4
IMW40R025M2HXKSA1	SP006021020	PG-T0247-3
IMZA40R025M2HXKSA1	SP006021023	PG-T0247-4
IMW40R036M2HXKSA1	SP006021029	PG-T0247-3
IMZA40R036M2HXKSA1	SP006021032	PG-T0247-4
IMLT40R045M2HXTMA1	SP006137771	PG-HDSOP-16
IMLT40R036M2HXTMA1	SP006138192	PG-HDSOP-16
IMLT40R025M2HXTMA1	SP006138199	PG-HDSOP-16
IMLT40R015M2HXTMA1	SP006138208	PG-HDSOP-16
IMLT40R011M2HXTMA1	SP006138249	PG-HDSOP-16
IMW40R045M2HXKSA1	SP006138255	PG-T0247-3
IMZA40R045M2HXKSA1	SP006138260	PG-T0247-4
IMT44R011M2HXTMA2	SP006157635	PG-HSOF-8
IMT44R015M2HXTMA2	SP006157636	PG-HSOF-8
IMT44R025M2HXTMA2	SP006157637	PG-HSOF-8

CoolSiC™ MOSFET 650 V Gen 2, 75 mΩ 追加

強力な第1世代トレンチSiC MOSFETをベースに、性能向上、柔軟性の拡大、堅牢性の強化を実現しています。システムの価格性能比を大幅に向上させ、ハードスイッチング/ソフトスイッチングの両トポロジーにおいて、効率、高周波スイッチング、信頼性の面で最高水準を達成しています。



主な特長

- > 優れた性能指数 (FOM)
- > 最も低いレベルの $R_{DS(on)}$
- > 高い堅牢性と総合的な品質
- > 広い駆動電圧範囲
- > ユニポーラ駆動に対応 $V_{GS(off)} = 0 \text{ V}$
- > 低い熱抵抗
- > .XT相互接合技術によるパッケージの改善
- > 上面および下面放熱
- > TOLLパッケージ: 全8 x 8 FETとピン互換

競合製品に対する優位性

- > TOLLはD2PAK、TO247、TO220を凌ぐ、卓越した信頼性、最も要求の厳しい高電力アプリケーションにおける最大レベルの電力密度を実現します
- > TOLT上面放熱パッケージは、水冷に適しており、同じ高さ2.3mmのQ-DPAKを補完します

製品関連情報/オンライン サポート

[製品ファミリー ページ](#)

主な利点

- > 部品点数の削減
- > コストあたりのシステム性能を最大化
- > きわめて高い信頼性
- > 高い効率と電力密度を実現
- > 組み立てと冷却の簡素化
- > 水冷 "ready"
- > ファンやヒートシンクを使用せずに設計可能
- > 低い寄生インダクタンス
- > 優れたゲート制御

対象アプリケーション

- > 単相ストリングインバーター ソリューション
- > 蓄電システム
- > 通信用SMPS
- > エッジSMPS
- > サーバーSMPS
- > TV SMPS
- > ヒューマノイドロボット充電
- > バッテリー充電
- > 軽電気自動車 (LEV)
- > Eバイク充電
- > 駆動機器
- > 住宅用エアコン
- > HVAC (暖房/換気/空調)

製品概要およびデータシートへのリンク

発注可能な部品番号	SP 番号	パッケージ
IMBG65R075M2HXTMA1	SP006051146	PG-T0263-7
IMW65R075M2HXKSA1	SP006051137	PG-T0247-3
IMZA65R075M2HXKSA1	SP006051142	PG-T0247-4
IMLT65R075M2HXTMA1	SP005969469	PG-HDSOP-16
IMTA65R075M2HXTMA1	SP006051132	PG-LHSOF-4

【 CoolSiC™ MOSFET 650 V Gen 2, 75 mΩ 追加】

FAQ
1 How does CoolSiC G2 650V perform compared to other vendors and G1? Generally, G2 performs very well if benchmarked with other vendors, thanks especially to very good FOMs (figures of merit). G2 also improves G1 performance, especially in switching capabilities
2 What are the unique selling points of CoolSiC G2 650V? Outstanding FOMs, unparalleled GOX reliability, driving voltage flexibility, .XT interconnect, granular portfolio and robust roadmap
3 What are the advantages of Thin-TOLL 8x8? Enables more compact designs, it costs less than other packages, it has a much-improved TCoB (thermal cycling on board) capability and $T_j=175^{\circ}\text{C}$ which is quite unique for an SMD
4 What are the advantages of TOLT and in general top side cooling? System simplification resulting more compact PCB design, improved stray inductance, enable liquid cooling to increase system power density
5 Do you provide mechanical expertise to support the design of top side cooling packages? Yes, we can assist the customer in the best way to design the top side cooling stack. We are also working close to early adopters to understand the best assembly options for this cooling methodology.

沿面距離を確保したTO-247 4ピンパッケージに搭載されたCoolSiC™ MOSFET G2 1400 V

十分な沿面距離を確保したパッケージとSiC技術とを組み合わせた製品です。1000 Vを超えるバス電圧での設計が可能です。既存のアプリケーションに電圧マージンの拡大と信頼性の向上を同時に提供します。さらに、高スイッチング周波数動作が可能なため、高い効率を実現します。既存製品とのピン互換性により、太陽光発電(PV)、電気自動車(EV)充電、エネルギー貯蔵システム(ESS)など、さまざまな産業アプリケーションに適しています。



主な特長

- > $V_{DSS} = 1400 \text{ V}$ ($T_{vj} = 25^\circ\text{C}$ 時)
- > $R_{DS(on)} = 11 \text{ m}\Omega$ ($V_{GS} = 18 \text{ V}$, $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$ 時)
- > きわめて低いスイッチング損失により高効率を実現
- > 短絡耐量時間 $2 \mu\text{s}$
- > 広い V_{GS} 範囲: $-10 \text{ V} \sim +25 \text{ V}$
- > IGBT並みの閾値電圧: $V_{GS(th)} = 4.2 \text{ V}$

主な利点

- > 高い電力密度
- > 全体的なシステム効率の向上
- > システム出力の向上
- > 冷却最適化の強化
- > 容易なシステム設計

競合製品に対する優位性

- > 1000 V超の設計が可能
- > 沿面距離を確保した高信頼性パッケージ
- > 過渡的な過負荷に対する高い耐量
- > 上限1000 Vのアプリケーション向けに、高いピーク電流での高速スイッチングに対応した十分な電圧マージン
- > 電力密度が高いため全体的なシステムサイズを削減

対象アプリケーション

- > EV充電
- > 蓄電システム
- > ストリングインバーター
- > 無停電電源装置(UPS)
- > 汎用モーター制御

ブロック図

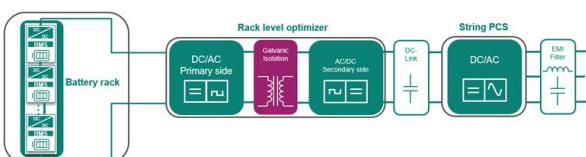
- > PV:



- > EV充電:



- > ESS:



製品関連情報/オンラインサポート

[製品ファミリーページ](#)

製品概要およびデータシートへのリンク

発注可能な部品番号	SP 番号	パッケージ
IMZC140R019M2HXKSA1	SP006073595	PG-TO247-4
IMZC140R024M2HXKSA1	SP006073599	PG-TO247-4
IMZC140R029M2HXKSA1	SP006073601	PG-TO247-4
IMZC140R038M2HXKSA1	SP006113484	PG-TO247-4

【沿面距離を確保したTO-247 4ピンパッケージに搭載されたCoolSiC™ MOSFET G2 1400 V】

FAQ
1 What is the availability of the CoolSiC™ MOSFET 1400 V G2?
Standard material is available at distribution center. In addition, samples are available through our supply chain channels.
2 What is the availability of the CoolSiC™ MOSFET 1400 V G2?
The TO-247-4 is pin-to-pin compatible with existing 1200 V SiC MOS products.
3 Any other package variants for CoolSiC™ 1400 V G2?
Yes, additional package variant of 1400 V will be available within 2025. The TO-247-4 Reflow package has been already launched in 2025.
4 When will the final version for G2 datasheet be ready
Product type pages are online & final DS are available.

LITIX™ Interior シリーズ初の製品: TLD4020-3ET

TLD4020-3ETは、保護機能付き出力段を備えた車載用LEDドライバーです。リニア電流シンク (LCS) で、最大51.5 mAの電流でRGB LEDを制御するよう設計されています。32ビットArm® Cortex®-M23マイコンを内蔵し、最適なカラーキャリブレーションの実現が可能です。各電源出力段は5ビットの電流設定値にて設定可能です。かつ、3つの独立した個別PWM設定が可能です。プログラミング制御と診断フィードバックにはLINインターフェースを採用しています。



主な特長

- > 最小レベルのリードパッケージ (TFDSO-16)
- > 3チャネル ドライバー (それぞれ最大51.5 mA)
- > LIN自動アドレス指定機能付きLINインターフェース
- > 32ビット Arm® Cortex®-M23
- > オンチップFlash 32 kB、オンチップSRAM 3 kB
- > 576バイト、1000 TP オンチップメモリ
- > 差動測定を備えた11ビットADC 0~8 V
- > 分解能16ビットのPWMエンジン@610 Hz
- > FW Flashルーチン起動用ブートROM
- > 内蔵オシレーター
- > 2線式シリアル ワイヤ デバッグ (SWD)
- > GPIO 2本

主な利点

- > 実績のあるマイコンを使った容易なプログラミング
- > アプリケーションの柔軟性を最大化
- > 容易で安定したソフトウェア開発
- > センシング機能および制御機能を追加

競合製品に対する優位性

- > 32ビットM23 Armコアで高い演算性能を実現
- > 十分な容量の32 kBフラッシュメモリ
- > カラーミキシングに最適なアプリケーション
- > ソフトウェアのパフォーマンス
- > 競合他社製品よりも優れた混色性能
- > 競合他社製品よりも高い効率

対象アプリケーション

- > 単一の光源を用い、一定または緩やかに変化する光のパターンによるコントゥア照明
- > 機能照明とスイッチ照明
- > 単一LEDで実現する面照明

製品関連情報/オンライン サポート

[製品ファミリーページ](#)

製品概要およびデータシートへのリンク

発注可能な部品番号	SP 番号	パッケージ
TLD40203ETXUMA2	SP006120896	PG-TFDSO-16

OptiMOS™ 7 40 V S3O8 Automotive MOSFET

インフィニオンは、銅クリップを採用した先進的な $3 \times 3\text{mm}^2$ のリードレスパッケージに搭載された、大電流、低 $R_{DS(on)}$ で、低パッケージ $R_{DS(on)}$ と最小レベルの浮遊インダクタンスを実現した新型パワーMOSFET製品ラインナップを発表しました。従来のリード付きパッケージに比べ、小型化を実現しつつ、高い電力密度、低い導通損失、最適化されたスイッチング特性を実現します。これによりインフィニオンは、電力分配、ボディ制御モジュール、電動モーターなど、多くの車載アプリケーションに理想的なソリューションを提供します。



主な特長

- > 小型フットプリント $3 \times 3\text{ mm}^2$
- > 大電流容量60 A
- > 最先端のOptiMOS™ 7 40 V技術
- > $R_{DS(on)}$ 範囲: 1.2 mΩ～4.9 mΩ
- > 銅クリップを採用した先進的なリードレスパッケージ、最小レベルの浮遊インダクタンス
- > 高アバランシェ耐性、高(安全動作領域(SOA))耐久性

主な利点

- > 高電力密度、高効率
- > 放熱効果の高いリードフレームパッケージ
- > 導通損失の低減
- > スイッチング動作の最適化
- > 従来のDPAK / D2PAKパッケージにくらべて小型
- > JEDEC業界標準パッケージPG-TSDSON-8

競合製品に対する優位性

- > 小型フットプリント $3 \times 3\text{ mm}^2$
- > 大電流容量60 A
- > 最先端のOptiMOS™ 7 40 V技術
- > $R_{DS(on)}$ 範囲は最小1.2 mΩ BiC
- > 銅クリップを採用した先進的なリードレスパッケージは、きわめて高効率なシステム設計と最小レベルの $R_{DS(on)}$ で、小型パッケージで高い電力密度、低い導通損失、最適化されたスイッチング特性を実現しています。

対象アプリケーション

- > 電源分配
- > ボディコントロールモジュール
- > ウィンドウリフト
- > パワーリフトゲート
- > シートアプリケーション
- > 電動パーキングブレーキ
- > EPS
- > 小型BLDCドライブ

製品関連情報/オンラインサポート

[製品ページ](#)

製品概要およびデータシートへのリンク

発注可能な部品番号	SP番号	パッケージ
IAUZN04S7L012ATMA1	SP006024823	PG-TSDSON-8
IAUZN04S7N013ATMA2	SP005927359	PG-TSDSON-8
IAUZN04S7L019ATMA1	SP006024827	PG-TSDSON-8
IAUZN04S7N020ATMA2	SP005927361	PG-TSDSON-8
IAUZN04S7L025ATMA1	SP006024831	PG-TSDSON-8
IAUZN04S7N026ATMA1	SP005831179	PG-TSDSON-8
IAUZN04S7L030ATMA1	SP006024835	PG-TSDSON-8
IAUZN04S7N032ATMA1	SP006024839	PG-TSDSON-8
IAUZN04S7L046ATMA1	SP005831208	PG-TSDSON-8
IAUZN04S7N049ATMA1	SP005979644	PG-TSDSON-8

2.2 kV 整流器を搭載したEconoPIM™ 3 FP75R17N3E4_B20

FP75R17N3E4_B20は、TRENCHSTOP™ IGBT4、エミッタ制御ダイオード4、NTC内蔵したEconoPIM™ 3 IGBTモジュールです。2.2 kV整流器とブレーキチョッパを統合したPIM (Power Integrated Module)により、システムコスト削減を実現します。690 V駆動に適しています。



Typical appearance

主な特長

- > 整流器の耐圧を2.2 kVに拡大
- > TRENCHSTOP™ IGBT4
- > 定格電圧2200Vの整流ダイオード
- > 低 V_{CEsat} 、低スイッチング損失
- > 絶縁性能 AC 2.5 kV/1分
- > 高信頼性、高電力密度
- > 热拡散を最適化する銅ベースプレート
- > 高電力密度
- > はんだ付け技術
- > RoHS対応モジュール

主な利点

- > 整流器の耐圧が高いため、グリッド障害に対する耐性が強化され、690 V駆動に最適です。
- > 高電力密度
- > 低損失のため、エネルギー効率要件に対応
- > 損失とEMIのトレードオフを最適化
- > システムコストの低減

競合製品に対する優位性

- > 堅牢性の向上

対象アプリケーション

- > 産業用モーター制御
- > 商用HVACシステム

製品関連情報/オンライン サポート

[製品ページ](#)

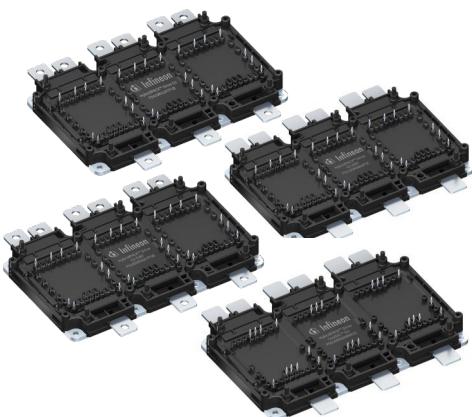
製品概要およびデータシートへのリンク

発注可能な部品番号	SP 番号	パッケージ
FP75R17N3E4B20BPSA1	SP002718480	AG-ECONO3B-411

HybridPACK™ Drive G2

HybridPACK™ Drive G2は、トラクションインバータ アプリケーション向けに最適化されたコンパクトなB6ブリッジパワーモジュールで、750 Vおよび1200 Vクラスにおいて最大300 kWまで拡張可能なスケーラビリティを提供します。

本製品は、様々な電流定格、電圧レベルに対応し、インフィニオンの次世代チップ技術であるEDT3 (Si IGBT) およびCoolSiC™ G2 MOSFETを採用しています。さらにHybridPACK™ Drive G2は、次世代位相電流センサーの統合オプションなど、システムコストの最適化を実現する新機能を提供します。



主な特長

- > 新しいIGBT EDT3とCoolSiC™トレンチMOSFET Gen2技術
- > 焼結によるダイアタッチ技術
- > 175°Cでの連続動作に対応
- > ダイオード温度センサー内蔵
- > 全温度範囲で高い堅牢性を確保したピンリベット
- > ピンフィンベースプレートによる直接水冷
- > PressFITコンタクト技術
- > RoHS準拠、鉛フリー

主な利点

- > 強化されたHybridPACK™ Drive G2モジュールにより、最大900Armsのピーク電流で動作
- > 温度サイクル耐性の向上
- > 動作温度を拡張する新しいプラスチック素材
- > システムBOMを削減する新しいフレーム設計
- > 優れた耐熱性を実現する高性能絶縁ゲル
- > AC接触抵抗の改善によるタブ温度の低下

競合製品に対する優位性

- > スケーラブルなインバータプラットフォームの開発を実現
- > 高いゲート信頼性と宇宙線耐量
- > 高い熱伝導率
- > 全温度範囲での高い堅牢性
- > 過酷な動作環境における高い耐久性

対象アプリケーション

- > 車載用トラクションインバータ
- > 商用車、建設機械、農業用車両 (CAV) 用トラクションインバータ
- > (ハイブリッド) 電気自動車 (H)EV

製品関連情報/オンライン サポート

[製品ファミリーページ](#)

製品概要およびデータシートへのリンク

発注可能な部品番号	SP 番号	パッケージ
FS410R12A7P1BHPA1	SP005675819	AG-HDG2XT-7611
FS1000R08A7P3BHPA1	SP005913585	AG-HDG2XT-7611
FS01MR08A8MA2CHPSA1	SP006071563	AG-HDG2XT-3311
FS1150R08A8P3CHPSA1	SP006071554	AG-HDG2XT-7661

OptiMOS™ 6 200 V MOSFET

スタティック スイッチング アプリケーションからハード スイッチングおよびソフト スイッチングテクノロジーベースの高周波アプリケーションまで、幅広いアプリケーションの要求に対応できるように設計されています。

OptiMOS™ 6 200 V テクノロジーは、先進的なセル構造を採用し、200 V クラスにおいて業界最小レベルの $R_{DS(on)}$ 、 Q_{rr} を実現しています。これにより、前世代製品に比べて、比類ない効率と電力密度を達成しています。



主な特長

- > 業界で最も低いレベルの $R_{DS(on)}$ 200 V MOSFET
- > 業界で最も低いレベルの Q_{rr} 200 V MOSFET
- > 200 V の前世代品に比べた特長:
 - > $R_{DS(on)}$ を最大42%低減
 - > $Q_{rr(typ)}$ を最大89%低減
 - > FOM_g を36%低減
 - > OptiMOS™ 5に比べてダイオードのソフトリカバリ特性が3倍向上
 - > 高いキャパシタンス直線性
 - > SOAが向上
- > $V_{gs(th)}$ のばらつきが小さく $\pm 750 \text{ mV}$
- > 高いアバランシェ耐量
- > 最大 T_j は175°C、モイスチャーレベル MSL1

主な利点

- > 低導通損失、低スイッチング損失
- > 優れたEMI性能による安定動作
- > 並列動作時の優れた電流分配
- > 堅牢性の向上
- > システムの信頼性向上

競合製品に対する優位性

- > 業界で最も低いレベルの $R_{DS(on)}$ および Q_{rr} @200 V
- > 高効率、高電力密度
- > 前世代の OptiMOS™ 5 に比べて価格性能比が向上
- > より高い性能と低価格の代替品で既存の市場セグメントに対応
- > 高い信頼性

対象アプリケーション

- > 通信、サーバー、急速充電器におけるSMPS
- > 太陽光発電、EESなどの再生可能エネルギー
- > 幅広いアプリケーションでのドライブ: フォークリフト、LEV、バッテリー駆動アプリケーション、ロボット、ドローン、サーボドライブ
- > バッテリー管理システム (BMS) におけるバッテリー保護
- > オーディオ

製品関連情報/オンライン サポート

[製品ページ](#)

製品概要およびデータシートへのリンク

発注可能な部品番号	SP 番号	パッケージ
ISC300N20NM6ATMA1	SP006070094	PG-TDSON-8

PQFN 8x6パッケージ搭載OptiMOS™ 60 V パワーMOSFET

PQFNパッケージのOptiMOS™ 60 V パワーMOSFETは、インフィニオンのMOSFETテクノロジーと超低寄生インダクタンスのコンパクトパッケージを組み合わせ製品です。これにより、あらゆる電源システムにおいて、業界で最小のR_{DS(on)}および最大の電力密度を実現し、スイッチング/導通損失および電流耐量が大幅に改善されています。低いパッケージ抵抗と高い電流処理能力が求められる幅広い電池駆動、電池保護、電池形成アプリケーションに対応し、低周波スイッチングおよび高周波スイッチング共に適しています。

MOSFETのPQFN 8x6ファミリーは、コンパクトなリードレスパッケージ (8x6mm) で提供され、最終製品の物理面積と総BOMを削減します。改善されたR_{DS(on)}およびドレン電流 (ID) 定格 (連続およびパルス) により、バッテリー駆動時間の延長、電力密度を向上させます。本パッケージのユニークな利点に、PQFN 5x6とのフットプリント互換性があり、同じ基板を高、中、低電力ソリューションに使用できます。



主な特長

- > コンパクトなパッケージサイズ (8x6mm) で高い電流耐量を実現
- > 業界で最も低いR_{DS(on)}とFOM
- > 超低パッケージ寄生容量 (抵抗およびインダクタンス) のリードレスパッケージ
- > 最新のOptiMOS™ MOSFET技術
- > PQFN 5x6とフットプリント互換

主な利点

- > 電力密度が高いため、コンパクトなボードで高出力設計が可能
- > 超低導通損失、低発熱、少ないデバイス並列
- > 低EMI
- > 最高クラスの電力密度と電力効率で優れた性能を発揮
- > さまざまな電力レベルに対応するスケーラブルでシンプルなPCB設計

競合製品に対する優位性

- > さまざまなアプリケーションで高電力、高電力密度を実現するベンチマーク製品
- > MOSFETの並列化を削減
- > フットプリントが、業界標準のPQFN 5x6パッケージと下位互換のため、高い性能へシームレスにアップグレードが可能
- > きわめて低いパッケージ寄生と発熱
- > 競合他社の8x8ソリューションより25%コンパクトなパッケージサイズ

対象アプリケーション

- > 電動工具/園芸用工具
- > モーター駆動
- > バッテリー管理
- > エネルギー貯蔵システム
- > LEV
- > ドローン/マルチコプター
- > ロボティクス

製品関連情報/オンライン サポート

[製品ページ](#)

製品概要およびデータシートへのリンク

発注可能な部品番号	SP 番号	パッケージ
IQFH61N06NM5ATMA1	SP005634650	PG-TSON-12
IQFH68N06NM5ATMA1	SP005634659	PG-TSON-12
IQFH86N06NM5ATMA1	SP005634663	PG-TSON-12
IQFH99N06NM5ATMA1	SP005634674	PG-TSON-12

【PQFN 8x6パッケージ搭載OptiMOS™ 60 V パワーMOSFET】

FAQ

1	How does the PQFN 8x6 package concept improve parasitics?
	The large Cu-clip, fused source leads and optimized chip dimensions enable very low package parasitics.
2	What facilitates the design in PQFN 8x6 products?
	Footprint compatibility with PQFN 5x6 enables easy modification of existing boards for re-use with PQFN 8x6 (Can easily replace 2xPQFN5x6). Significant improvement in power density when used to replace TOLL.
3	What is decisive to reduce conduction losses at full load?
	Optimal thermal management along with use of low $R_{DS(on)}$ products will help reduce conduction losses.

StrongIRFET™ 2 パワー MOSFET 30 V、D²PAKパッケージ

30 V StrongIRFET™ 2ファミリーの最新ラインアップを発表。SMPS、アダプター、モーター駆動、バッテリー管理、電動工具、園芸工具をはじめ、30 V MOSFETを採用するあらゆる民生機器アプリケーションに幅広く対応します。

新製品のラインアップは、優れた堅牢性とコストパフォーマンスを実現し、従来のStrongIRFET™ 30 V技術に比べ、 $R_{DS(on)}$ を最大40%、FOMQ_gを最大60%低減しています。

既存のTO-220、DPAK PQFN 3.3 x 3.3、SuperSO8 5x6パッケージに、新たにD²PAKパッケージの製品が加わりました。これにより、デザインインが容易になり、販売代理店での選定や購入が便利になります。



主な特長

- > 汎用製品
- > 優れた耐久性と価格性能比
- > 販売代理店で幅広く入手可能
- > 標準的なパッケージおよびピン配置
- > 優れた生産および供給基準

主な利点

- > 多様なアプリケーションに対応
- > 高品質で競争力のある価格
- > 製品選択と購入の容易さ
- > 設計の容易さ
- > シンプルな製品サービス

競合製品に対する優位性

- > 最適な製品を柔軟に使用可能
- > 高い信頼性
- > システムコストの削減
- > 複数の供給元
- > 短いリードタイム
- > 複数の設計に対応したドロップイン置換品
- > 信頼性の高いデリバリーと安定した供給

対象アプリケーション

- > モーター制御
- > 電動工具
- > ガーデニング工具
- > BMS
- > アダプター
- > マルチコプター
- > 産業用SMPS
- > コンシューマー向け機器

製品関連情報/オンライン サポート

[製品ファミリーページ](#)

製品概要およびデータシートへのリンク

発注可能な部品番号	SP 番号	パッケージ
IPB018N03LF2SATMA1	SP005860606	PG-T0263-3
IPB020N03LF2SATMA1	SP005859620	PG-T0263-3
IPB023N03LF2SATMA1	SP005901738	PG-T0263-3

XENSIV™ - TLE49SRS8D / TLE49SRC8D デュアル角度センサー

浮遊磁場耐性の高い角度センサーファミリーに、新たに

XENSIV™TLE49SRC8Dデュアル角度センサーが加わりました。

TLE49SRx8Dデュアル角度センサーは、インターフェースとしてSENTおよびSPCに対応しています。TDSO-8パッケージのオプションは、次世代ステアリングシステムなどのアプリケーションにおける基板実装設計に最適です。

安全がきわめて重要な車載システムのEMI(電磁耐性)要件に解決策を提供します。



主な特長

- > 高い外部磁界耐性
- > EMC規格ISO 11452-1:2015の要件を大きく上回るスペック
- > 磁界範囲20~90 mTによる高い設計柔軟性
- > 優れた角度検出性能、低ジッタ性能、高速応答
- > SEooC (Safety element out of context)としてISO 26262に準拠して開発
- > コンポーネントレベルでASIL C (自動車安全インテグリティレベル)を達成
- > 使用可能な通信インターフェース
- > SENT (Single Edge Nibble Transmission)
- > SPC (Short PWM code)

主な利点

- > 最大8mTの外部磁界耐性による堅牢性
- > 静的角度誤差補正用のルックアップテーブル
- > 超低ジッタ遅延ばらつき±1 µs
- > 超高速応答時間9.8 µs~26 ms(設定可能)
- > ISO 26262に準拠した開発プロセスで機能安全設計が可能
- > EEPROMによる設定や顧客固有のID保存が可能
- > SPCインターフェースのフレームホルダー機構により、1線での複数接続ながら他のセンサーとの同期データ取得が可能

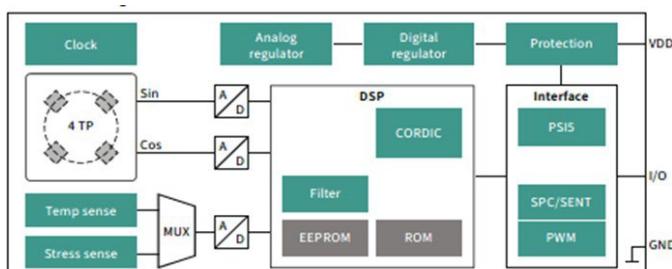
競合製品に対する優位性

- > ISO 11452-8を上回る品質、最大8mTの外部磁場耐性
- > 角度誤差0.5°未満
- > ルックアップテーブルで角度誤差を補正
- > フレームホルダーで同期データ取得に対応
- > SEooC (ASIL C)としてISO 26262に準拠

対象アプリケーション

- > 電動パワーステアリング用トルク角センサー(TAS)
- > 電動パワーステアリング用舵角センサー(SAS)
- > ペダルポジションセンサー
- > シャシー ハイト レベリング センサー
- > スロットル ポジション センサー

ブロック図



製品関連情報/オンラインサポート

製品ファミリーページ

製品概要およびデータシートへのリンク

発注可能な部品番号	SP 番号	パッケージ
TLE49SRC8DXUMA1	SP005859106	PG-TDSO-8
TLE49SRS8DXUMA1	SP005948428	PG-TDSO-8

評価ボード EVAL_TDA38725A_xxVOUT

EVAL_TDA38725A_1.1VOUT および EVAL_TDA38725A_3.3VOUTは、PMBusおよび／またはピンストラップ レジスタを使用して、OptiMOS™ IPOL 単一電圧同期降圧レギュレータTDA38725A ICの完全な設定を可能にします。3ピンのオンボード ヘッダーでIC-PC間の通信を確立するのにUSBドングルを使用します。インフィニオンのXDP™ Designer GUIは、TDA38725A ICのインターフェースとプログラミングに使用します。



主な特長

- > 強制連続導通モード
- > ダイオードエミュレーション
- > プログラム可能なスイッチング周波数
- > モノトニック起動
- > プリバイアス起動強化
- > 熱補償型内部過電流保護機能

主な利点

- > 13～24回書き込みが可能なMTP (Multiple Time Programming) 機能
- > 小型PQFNパッケージ (5x6mm2)
- > PMBus通信
- > 軽負荷時の効率を改善

製品関連情報/オンライン サポート

ボードページ:

- > [EVALTDA38725A11VOUTTOBO1](#)
- > [EVALTDA38725A33VOUTTOBO1](#)

対象アプリケーション

- > AIアクセラレーターカード
- > AMDサーバーCPU
- > SmartNIC
- > ネットワークおよびスイッチ プラットフォーム
- > データセンターアプリケーションのFPGA

製品概要およびユーザーガイドへのリンク

発注可能な部品番号	SP 番号
EVALTDA38725A11VOUTTOBO1	SP006032930
EVALTDA38725A33VOUTTOBO1	SP006010274

【評価ボードEVAL_TDA38740A_xxVOUT】

FAQ

How does the PQFN 8x6 package concept improve parasitics?

Fast COT engine allows better transients and Vout regulation while Infineon FETs enable better efficiency

評価ボード EVAL_TDA38740A_xxVOUT

EVAL_TDA38740A_1.1VOUTおよびEVAL_TDA38740A_3.3VOUTは、SVIDおよびPMBus、あるいはPMBusのみの通信インターフェースを備えた同期降圧コンバータの本製品は、コンパクトなQFNパッケージで、コンパクトかつ高性能で柔軟なソリューションを提供します。これらの評価ボードは、設計プロセスにおいて特性曲線の評価や測定を行い、各種部品特性を理解するのに使用されます。



主な特長

- > 強制連続導通モード
- > ダイオードエミュレーション
- > プログラム可能なスイッチング周波数
- > モノトニック起動
- > プリバイアス起動強化
- > 熱補償型内部過電流保護機能

主な利点

- > 13～24回書き込みが可能なMTP (Multiple Time Programming) 機能
- > 小型PQFNパッケージ (5x6mm2)
- > PMBus通信
- > 軽負荷時の効率を改善

製品関連情報/オンライン サポート

ボードページ:

- > [EVALTDA38740A11VOUTTOBO1](#)
- > [EVALTDA38740A33VOUTTOBO1](#)

対象アプリケーション

- > AIアクセラレーターカード
- > AMDサーバーCPU
- > SmartNIC
- > ネットワークおよびスイッチ プラットフォーム
- > データセンターアプリケーションのFPGA

製品概要およびユーザーガイドへのリンク

発注可能な部品番号	SP 番号
EVALTDA38740A11VOUTTOBO1	SP006032929
EVALTDA38740A33VOUTTOBO1	SP006010272

【評価ボードEVAL_TDA38740A_xxVOUT】

FAQ

- How does Fast COT compare to alternative COT parts
- Fast COT engine allows better transients and Vout regulation while Infineon FETs enable better efficiency

評価デモボード：IPOLシングル出力同期電圧レギュレータ TDA38640A 用 1.0 Vout

OptiMOS™ IPOL TDA38640Aは、SVID通信インターフェースを備えた同期式降圧コンバータで、コンパクト、コンパクトなQFNパッケージに高性能、柔軟性を兼ね備えたソリューションを提供します。

本評価ボードは、設計プロセスにおいて特性曲線の評価や測定を行い、各種部品特性を理解するのに使用されます。



主な特長

- > 広い入力電圧範囲: 3.0 V～17 V
- > 出力電圧範囲: 0.25 V～3.04 V
- > スイッチング周波数: 400 kHz～2 MHz
- > 外部補償不要の高速COT
- > オプションの強制連続導通モード
- > 報告用のI2Cシステム インターフェース
- > モノトニック起動、ソフトスタート時間
- > 熱補償型内部過電流保護機能
- > 高い安定性のエンジン
- > Intel SVIDおよびI2C準拠
- > PQFNパッケージ 5x6mm

主な利点

- > 優れた過渡応答性
- > 正確な出力電圧の調整
- > 高精度な出力電圧調整
- > 高効率、高出力密度

製品関連情報/オンライン サポート

[ボードページ](#)

対象アプリケーション

- > 通信インフラ向けDC-DC電力変換
- > エッジ コンピューティング
- > IntelサーバーCPU

製品概要およびユーザーガイドへのリンク

発注可能な部品番号	SP 番号
EVALTDA38640A10VOUTTOBO1	SP006010270

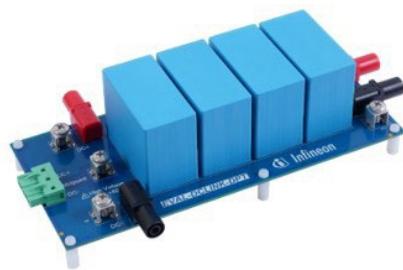
【評価デモボード：IPOLシングル出力同期電圧レギュレータ TDA38640A 用 1.0 Vout】

FAQ

- How does Fast COT compare to alternative COT parts
- Fast COT engine allows better transients and Vout regulation while Infineon FETs enable better efficiency

安全放電機能付きコンデンサー基板EVAL-DCLINK-DPT

EiceDRIVER™ゲートドライバーICおよびTO263-7パッケージのCoolSiC™ MOSFET 1200 V G2と接続できる、ダブルパルス試験用のコンデンサー・バンクを提供します。評価ボードを使用することで、インフィニオンのディスクリート・パワートランジスタおよびゲートドライバーを容易に評価できます。本ボードは、インフィニオンのモジュラー評価プラットフォームと連携して動作するよう設計されています。



主な特長

- > 最大バス電圧800 V
- > 視覚安全表示付き放電回路
- > 異なるゲートドライバー／パッケージボード間の相互接続
- > 負荷インダクタのブレークアウト接続
- > TO-263-7パッケージに搭載された1200 V CoolSiC™ MOSFET G2
- > ゲートドライバー: EiceDRIVER™ 1ED3142MC12H

主な利点

- > インフィニオンのパワー半導体およびゲートドライバーの機能、性能、特長を評価するのに最適

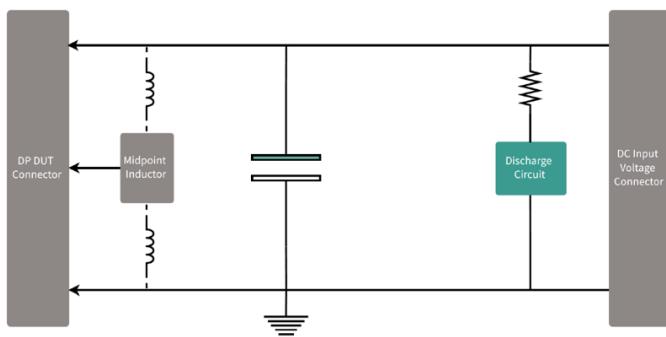
競合製品に対する優位性

- > インフィニオン製のゲートドライバーやパッケージ基板の各種テストを行うことが可能

対象アプリケーション

- > ESS
- > EV充電
- > ドライバー
- > 太陽光発電
- > 無停電電源装置 (UPS)

ブロック図



製品関連情報/オンラインサポート

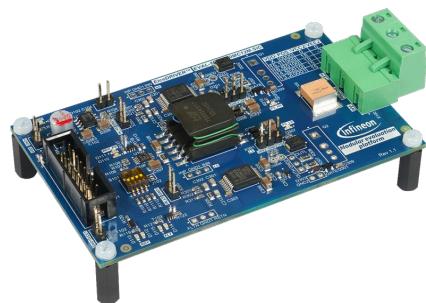
[製品ページ](#)

製品概要およびユーザーガイドへのリンク

発注可能な部品番号	SP 番号	パッケージ
EVALDCLINKDPTTOBO1	SP006143298	LG-MADK-1

1ED3330MC12M用評価デモボード

本評価デモボードは、ハーフブリッジ構成の1ED3330MC12M絶縁ゲートドライバーICとディスクリート電源スイッチの動作評価を目的に設計されています。この基板には、2個の1ED3330MC12Mと、2EP130RトランジストライバーICを使用する絶縁型オンボード電源が搭載されています。基板には、未実装のIMZC120R012M2H CoolSiC™が2つ含まれます。



主な特長

- > 1ED3330MC12M絶縁ゲートドライバーIC
- > IMZC120R012M2H 1200 V SiC MOSFET
- > 2EP130RトランジストライバーIC
- > DESAT保護、ソフトオフ
- > アクティブミラークランプドライバー
- > フォルト検出で遮断

主な利点

- > 容易な測定および設定
- > オンボード電源
- > ハーフブリッジ構成
- > スイッチは非搭載
- > インフィニオンのモジュラー評価プラットフォームの一部

競合製品に対する優位性

- > TO247-4パッケージの異なるインフィニオン製スイッチを短時間で評価可能

対象アプリケーション

- > 蓄電システム
- > EV充電
- > 産業用モーター制御

製品関連情報/オンラインサポート

[製品ページ](#)

製品概要およびユーザーガイドへのリンク

発注可能な部品番号	SP 番号
EVAL1ED3330MC12MSICTOBO1	SP006170682

XENSIV™ PAS CO2 5V CSK (Connected Sensor Kit)

XENSIV™ KIT CSK PASCO2 5 Vは、インフィニオン製品を使用したカスタムIoTソリューションの迅速な開発を実現します。センサー駆動のIoT製品やユースケースの効率的なテストとプロトタイピングが行えます。リアルタイムでのセンサー評価とクラウドベースでのPAS CO2 5 Vセンサーデータの可視化により、アプリケーションを迅速に評価、改良することができ、最適な性能と精度を確保できます。



主な特長

- > リアルタイムでCO2センサーのデータを評価
- > Adafruit featherと互換性のあるフォームファクター
- > デュアルコア、低消費電力のPSOC™ 6マイコン
- > Wi-FiおよびBluetooth®コンボ無線モジュール
- > 交換可能なセンサーワイブ
- > ModusToolbox™へのシームレスな実装

主な利点

- > IoT、バッテリー駆動機器に最適
- > お客様側でのフィールドトライアルに最適
- > サンプルコードを使った迅速なプロトタイプ作成
- > OPTIGA™を使ったセキュアなクラウド接続
- > デバイスのセキュアなプロビジョニング

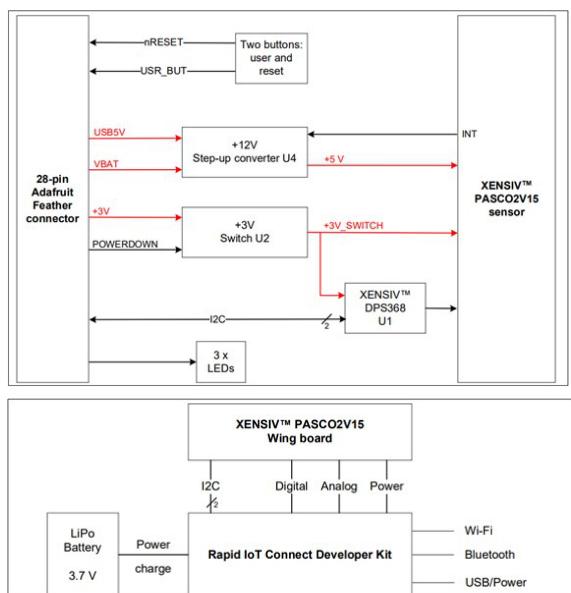
競合製品に対する優位性

- > 交差反応性のない高選択性CO2測定
- > 高品質データ、堅牢な性能、長期安定性
- > WELL™建築基準への適合
- > ISO 20653:2013-02に準拠した防塵設計
- > RoHS対応、ハロゲンフリー素材

対象アプリケーション

- > HVAC
- > スマート サーモスタット
- > IoT
- > 民生用機器
- > スマート冷蔵庫
- > スマート園芸

ブロック図



製品関連情報/オンライン サポート

[製品ページ](#)

製品概要およびユーザーガイドへのリンク

発注可能な部品番号	SP 番号
KITCSKPASCO25VTOBO1	SP006070836